

### 用 途

- ・ 液晶ガラス、ハードディスク、フォトマスク等の研磨材

### 概要・特徴

- ・  $\text{CeO}_2$  砥粒により高レート、低ダメージな加工が可能
- ・ 一次研磨から最終仕上げまで各用途に適した豊富なラインナップ
- ・ 様々な添加剤を用いる事で、お客様の使い方に合わせたカスタマイズが可能



粉末系



スラリー系

| 品種      | 性状   | 平均粒径 (μm) | 主な用途                         |
|---------|------|-----------|------------------------------|
|         |      | レーザー回折    |                              |
| HL05    | 粉末   | 0.5~0.9   | 最終仕上げ用                       |
| HL10    |      | 0.8~1.3   | 最終仕上げ用                       |
| HL21    |      | 1.0~1.4   | 最終仕上げ用                       |
| HL30    |      | 1.2~1.7   | 1次研磨用                        |
| HL40    |      | 1.5~2.3   | 1次研磨用                        |
| HL030CS | スラリー | 0.2~0.3   | 最終仕上げ用                       |
| HL020CS |      | 0.1~0.2   | 最終仕上げ用                       |
| K020C   |      | 0.08~0.15 | 最終仕上げ用<br>コロイダルシリカ代替<br>/開発品 |

※上記データは代表値であり、規格値ではありません。